

### 請求の範囲

- [請求項1]            基材層と、ヒートシール層と、を少なくとも有し、  
                     前記ヒートシール層が、スチレン系炭化水素と共役ジエン系炭化水素との共重合体（A）を含有し、  
                     前記（A）成分が、スチレン系炭化水素10質量%以上50質量%未満と共役ジエン系炭化水素50質量%超90質量%以下とのブロック共重合体（A-1）と、スチレン系炭化水素50質量%以上95質量%以下と共役ジエン系炭化水素5質量%以上50質量%以下とのブロック共重合体（A-2）と、を含み、  
                     前記（A-1）成分の含有量が、前記ヒートシール層全量を基準として、35～60質量%であり、  
                     前記（A-1）成分に対する前記（A-2）成分の質量比が、0.30～1.0である、カバーテープ。
- [請求項2]            前記ヒートシール層が、エチレン系重合体（B）を更に含有する、請求項1に記載のカバーテープ。
- [請求項3]            前記（B）成分が、エチレン- $\alpha$ -オレフィン共重合体及びエチレン-（メタ）アクリル酸メチル共重合体のうちの1種以上を含む、請求項2に記載のカバーテープ。
- [請求項4]            収容部を有するキャリアテープと、前記キャリアテープの前記収容部に収容された電子部品と、蓋材として前記キャリアテープにヒートシールされた請求項1～3のいずれか一項に記載のカバーテープと、を備える、電子部品包装体。